



中华人民共和国国家标准

GB/T 2036—94

印制电路术语

Terms for printed circuits

1994-12-28发布

1995-08-01实施

国家技术监督局 发布

目 次

1 主题内容与适用范围	(1)
2 一般术语	(1)
3 基材	(3)
4 设计	(10)
5 制造	(16)
6 检测	(24)
7 装联	(31)
附录 A 汉语索引(补充件)	(36)
附录 B 英文索引(补充件)	(43)

本标准参照采用国际标准 IEC 194《印制电路术语和定义》(1988 年版)。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了印制电路技术的常用术语及其定义。

本标准适用于印制电路用基材、印制电路设计与制造、检测与印制板装联及有关领域。

2 一般术语

2.1 印制电路 printed circuit

在绝缘基材上,按预定设计形成的印制元件或印制线路以及两者结合的导电图形。

2.2 印制线路 printed wiring

在绝缘基材上形成的导电图形,用于元器件之间的连接,但不包括印制元件。

2.3 印制板 printed board

印制电路或印制线路成品板的通称。它包括刚性、挠性和刚挠结合的单面、双面和多层印制板等。

2.4 单面印制板 single-sided printed board

仅一面上有导电图形的印制板。

2.5 双面印制板 double-sided printed board

两面均有导电图形的印制板。

2.6 多层印制板 multilayer printed board

由多于两层导电图形与绝缘材料交替粘结在一起,且层间导电图形互连的印制板。本术语包括刚性和挠性多层印制板以及刚性与挠性结合的多层印制板。

2.7 刚性印制板 rigid printed board

用刚性基材制成的印制板。

2.8 刚性单面印制板 rigid single-sided printed board

用刚性基材制成的单面印制板。

2.9 刚性双面印制板 rigid double-sided printed board

用刚性基材制成的双面印制板。

2.10 刚性多层印制板 rigid multilayer printed board

用刚性基材制成的多层印制板。

2.11 挠性印制板 flexible printed board

用挠性基材制成的印制板。可以有或无挠性覆盖层。

2.12 挠性单面印制板 flexible single-sided printed board

用挠性基材制成的单面印制板。

2.13 挠性双面印制板 flexible double-sided printed board